

双组份导热凝胶

TF200K是一款双组分的1:1混合固化的导热凝胶，常温固化，也可根据客户使用需要加热固化，固化后导热系数2.0W/(m·K)，该产品柔韧性好，适用于点胶化大批量的工序，提高生产效率。



特性和优点

- 导热系数2.0W/(m·K)
- 易点胶
- 固化时间可调
- 优异的高低温机械及化学稳定性
- 低压缩力应用

典型应用

- 汽车电子
- 光纤通讯设备
- SSD
- 网通设备及模组
- 发热半导体及散热器之间
- 电池包及冷板之间

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	白色/黄色	目视
粘度(cps)	A: 28±5万； B: 28±5万	ASTM D2196 @7号转子, 转速10rpm
触变指数	5±1	AOK Method
操作时间(min) @25°C	>60	可根据客户需求调整
固化时间(h) @25°C	<8	
密度(g/cc)	2.55	ASTM D792
固化硬度(Shore OO)	45	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	6	温度<40°C密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	>9.0	ASTM D149
介电常数	6.7	ASTM D150 @1MHz
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	≥2.0	ISO 22007-2